

应用介绍**特点**

一款双组份环氧树脂胶，常温固化，具有高粘接强度，广泛的粘接性，适用于电子器件结构性粘接和电子零部件的灌封；具有很好的防水效果

粘接材料

金属，塑料/PCB，玻璃，陶瓷等

典型应用

电子元器件或者手机内部的灌封，粘接。

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	A: 无色; B:淡黄色	
粘度(cps)	A:14000; B:28000	10rpm@25°C, ASTM D-1084
混合比例 (体积)	1:1	
固化条件*	24hrs@25°C	
表干时间	25m@25°C	
凝胶时间	5-10m@25°C	
Pot life	3-5m	
有效期@ 25°C,月	12	

*固化温度是指胶水表面实际达到的温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	浅黄	
邵氏硬度	45D	ASTM D-2240
玻璃化温度	NA	DSC,TAQ20, 40°C/Min

储存和使用方法

请将产品常温25°C下储存，建议储存在干燥通风处，可以用1:1手动胶枪点胶，也可自动化点胶；点胶前请废弃掉开始混合部分少量胶水等混合均匀后再使用；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考SDS文件；

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

